

No.	History	Version	Owner
1	First Issue	1.0	Lemon
2	删除 SOT23-3 封装形式;修改产品选型和打标信息;以及包装卷盘信息	1.1	Lee

Signature

QA: _____ Date: _____

AE: _____ Date: _____

FAE: _____ Date: _____

PD: Date: _____

R&D: Date: _____

Market: Date: _____

GM: Date: _____

■ 概述

JC75HXX系列是专为功耗敏感应用研发设计的一款高输入电压、超低功耗的低压差线性稳压器。

最大允许的输入电压可达35V，且输出100mA电流时输入输出电压差仅300mV。典型情况下，静态电流1.6 μ A，具有几个固定的输出电压1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V。

IC内部集成了短路保护和热关断功能。

尽管主要为固定电压调节器而设计，但这些IC可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。

■ 特点

- 超低静态电流 1.6 μ A
- 宽输入电压范围 $V_{OUT}+1V$ 至 35V
- 大输出电流 $\geq 200mA$
- 系统启动无过冲
- 短路保护释放无过冲
- 低压降
30mV@10mA
300mV@100mA
600mV@200mA
- 多种固定输出电压: 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V
- 输出电压精度:
 $JC75HXX \pm 2\%$
- 较好的电源/负载瞬态响应
- 低温度漂移 $\pm 100ppm/^{\circ}C$
- 短路保护功能
- 过热保护功能
- 多种封装类型，适合不同应用需要

JC75HXXSC	SOT23
JC75HXXTG	SOT23-5
JC75HXXTS	SOT89-3
JC75HXXTY	TO92

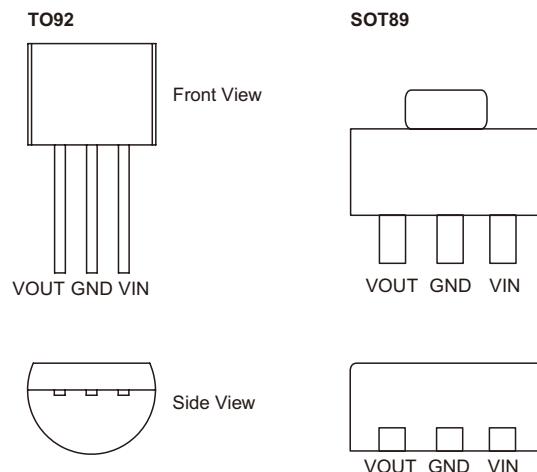
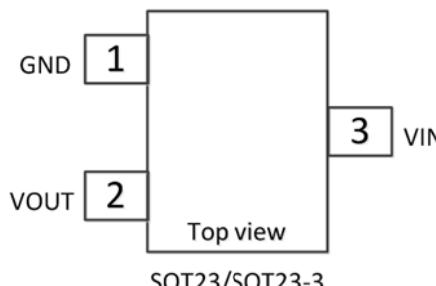
■ 应用

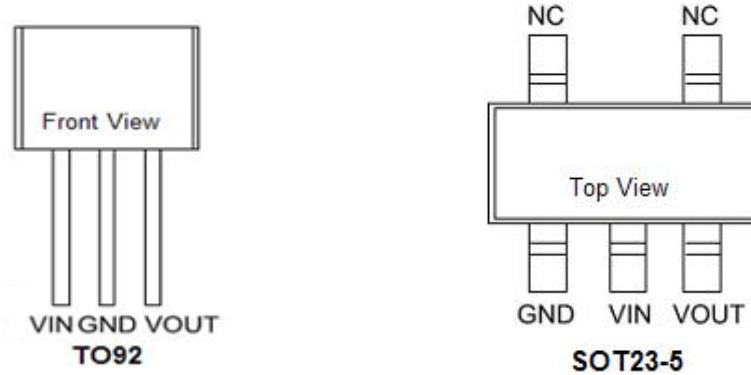
- 电池供电设备
- 烟雾传感器
- 微控制器
- 家用电器与仪器

■ 引脚定义

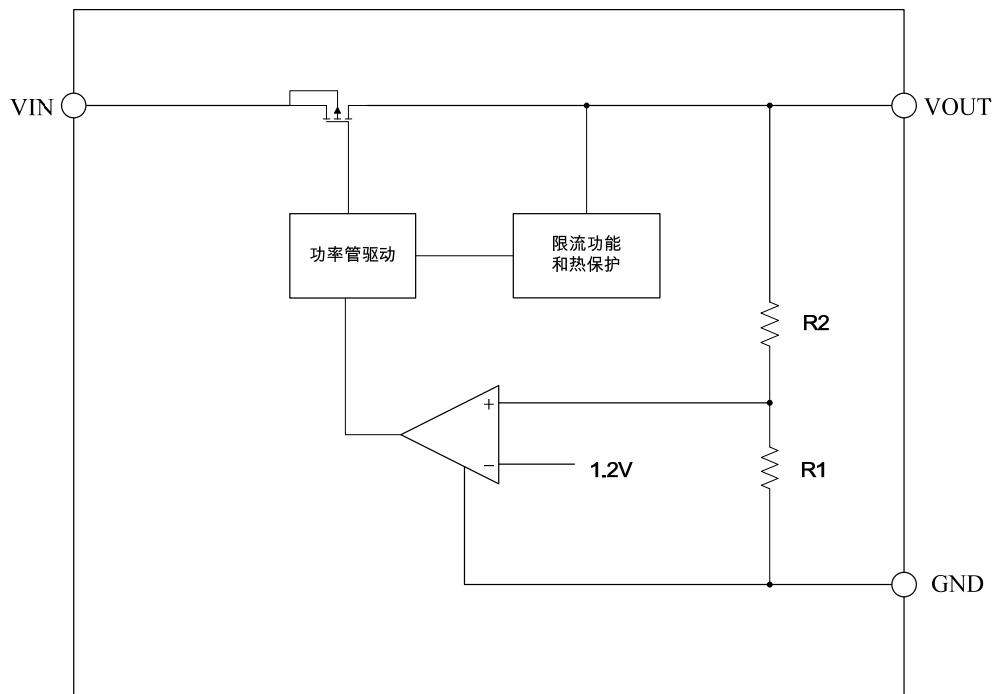
Pin		Symbol	Description
SOT23-3	SOT89-3/TO92-3		
1	2	GND	系统地电位，接输入电源的负端，用电设备供电的负端，以及输入电容和输出电容的负极
3	1	VOUT	线性稳压器的输出，接输出电容正极以及用电设备供电的正端
2	3	VIN	线性稳压器的输入正端，接输入电源的正端，以及输入电容的正极

■ 封装形式及引脚分布





■ 方框图



■ 绝对最大额定参数

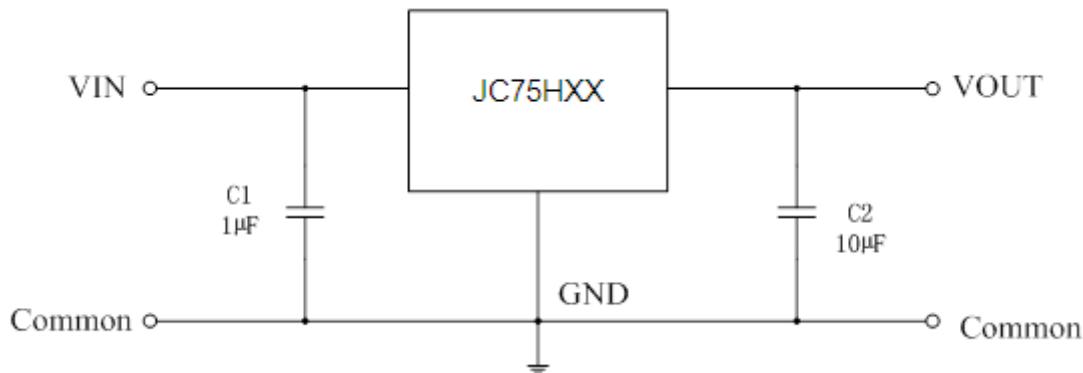
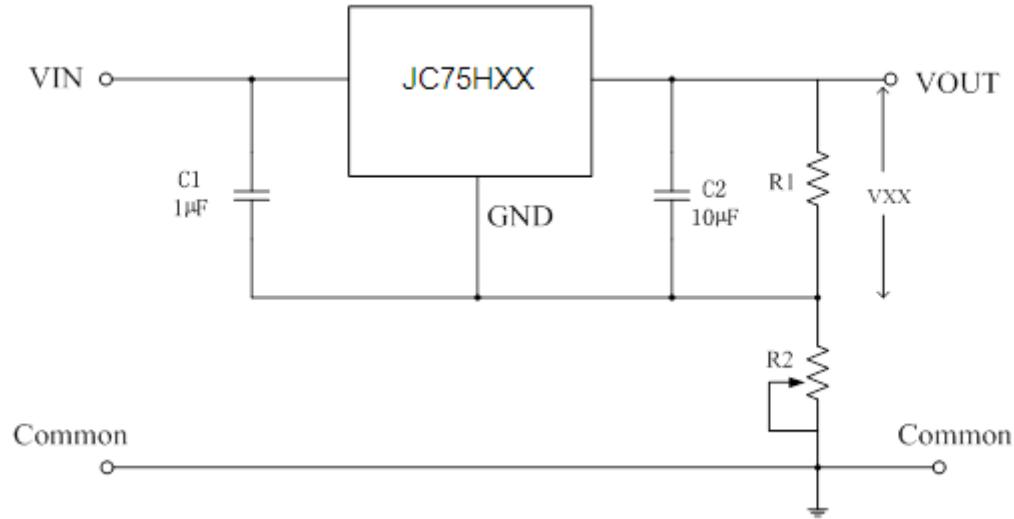
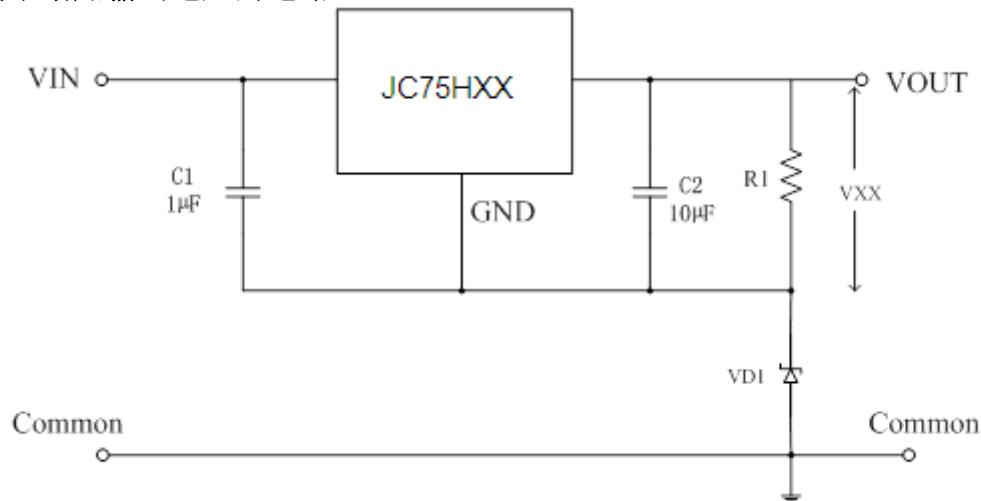
Characteristics	Description	Min	Max	Unit
电压	VIN脚对GND脚的耐压	-0.3	40	V
	VOUT脚对GND脚的耐压	-0.3	6	V
	VOUT脚对VIN脚的耐压	-35	0.3	V
电流	峰值电流	内部限流		
温度	工作环境温度	-40	85	°C
	存储温度	-40	150	°C
	最大结温	-	150	°C
封装热阻	SOT23	350		°C/W
	SOT23-5	260		°C/W
	SOT89-3	165		°C/W
	TO92	180		°C/W
封装最大允许功耗	SOT23	350		mW
	SOT23-5	480		mW
	SOT89-3	750		mW
	TO92	690		mW
静电释放能力	人体模式 (HBM)	-	5	kV
	机械模式 (MM)	-	500	V

注：超过额定参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预料芯片在额定参数范围外的工作状态，而且若长时间工作在额定参数范围外，可能影响芯片的可靠性。

■ 电气参数 (除特殊说明外, 以下参数均在 TA=25°C, C_{IN}=1uF, V_{IN}=V_{OUTNOM}+1V, C_{OUT}=10μF 条件下测试)

Symbol	Characteristics	Conditions	Min	Typ.	Max	Unit
V _{IN}	输入电压		3		35	V
I _{GND}	静态电流	无负载		1.6	2.0	μA
V _{OUT(JC75HXX)} , V _{OUT(JC75HXX)}	输出电压	I _{OUT} =10mA	-1%		1%	V _{OUT}
			-2%		2%	V _{OUT}
I _{OUT}	输出电流		200	250	—	mA
V _{DROP}	Dropout电压 ^{*1} (JC75H50)	I _{OUT} =10mA ΔV _{OUT} = - V _{OUTNOM} *2%	—	30	50	mV
		I _{OUT} =100mA ΔV _{OUT} = - V _{OUTNOM} *2%	—	300	400	mV
		I _{OUT} =200mA ΔV _{OUT} = - V _{OUTNOM} *2%	—	600	750	mV
	Dropout电压 (JC75H33)	I _{OUT} =10mA ΔV _{OUT} = - V _{OUTNOM} *2%	—	30	50	mV
		I _{OUT} =100mA ΔV _{OUT} = - V _{OUTNOM} *2%	—	300	400	mV
		I _{OUT} =200mA ΔV _{OUT} = - V _{OUTNOM} *2%	—	600	750	mV
ΔV _{OUT}	负载调整率	1mA≤I _{OUT} ≤100mA	—	20	50	mV
ΔV _{OUT} x100/ ΔV _{IN} x V _{OUT}	输入电压调整率	I _{OUT} =1mA, V _{IN} =(V _{OUTNOM} +1V) to 30V	—	—	0.2	%/V
I _{LIMIT}	限流保护	V _{IN} =(V _{OUTNOM} +1V) to 30V R _{LOAD} =V _{OUTNOM} /1A		450		mA
T _{SHDN}	过热保护			125		°C
TC _{VOUT}	温度系数	I _{OUT} =10mA -40°C≤TAMB≤100°C		±100		ppm/°C

注: *1 Dropout 电压定义为输出电压较其标称值下降 2%时对应的输入输出电压差。

■ 应用电路**➤ 典型应用电路****➤ 用于增加输出电压的电路 1****➤ 用于增加输出电压的电路 2**

■ 应用说明

➤ 功耗计算

内置功率管的功耗 P_D (MOSFET) = $(V_{IN}-V_{OUT})*I_{OUT}$

芯片整体功耗 $P_D(TOTAL)=PD(MOSFET)+V_{IN}*I_{GND}$

静态电流 I_{GND} 为 1.6uA, $V_{IN}*I_{GND}$ 功耗可忽略不计, 因此最坏情况的功耗为:

$$P_D(max)=[V_{IN}(max)-V_{OUT}(min)]*I_{OUT}$$

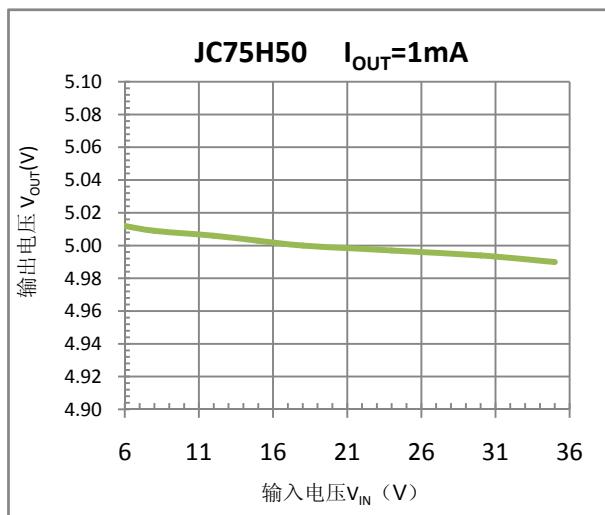
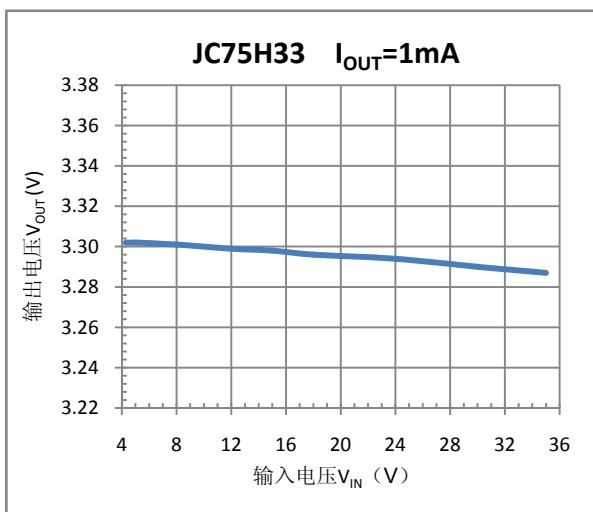
➤ 结温

$$T_J=P_D(max)*\theta_{JA}+T_A$$

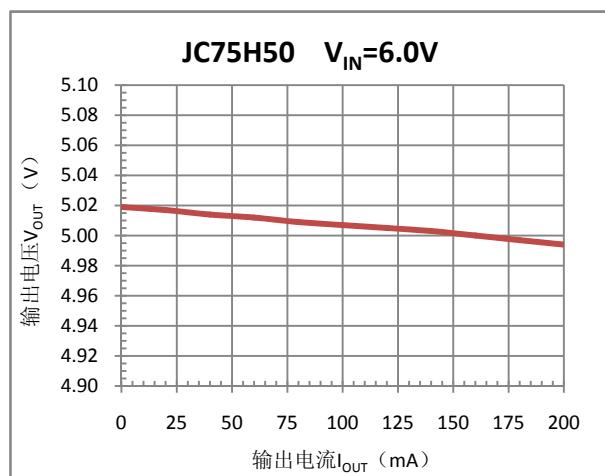
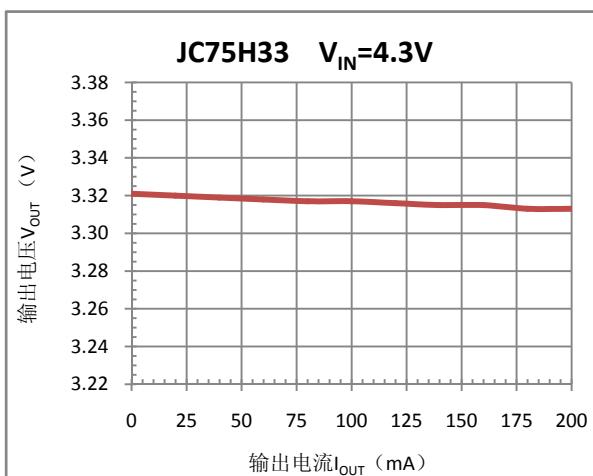
式中 θ_{JA} 表示封装热阻, T_A 表示环境温度。

■ 典型性能特点

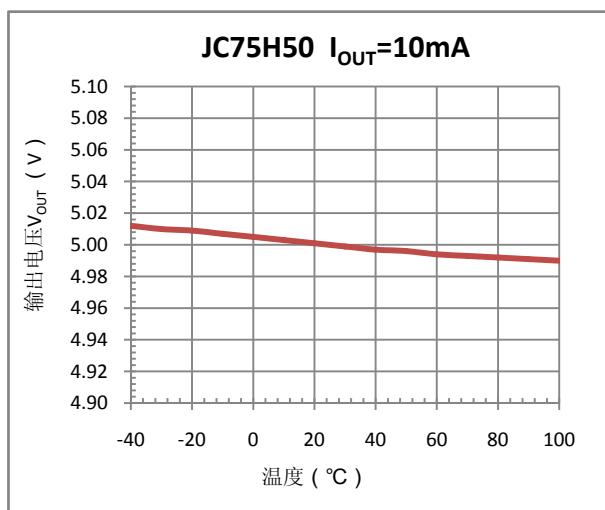
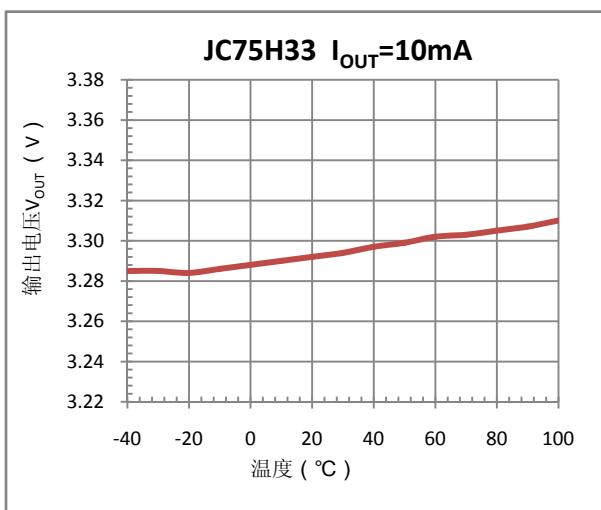
输出电压随输入电压的变化



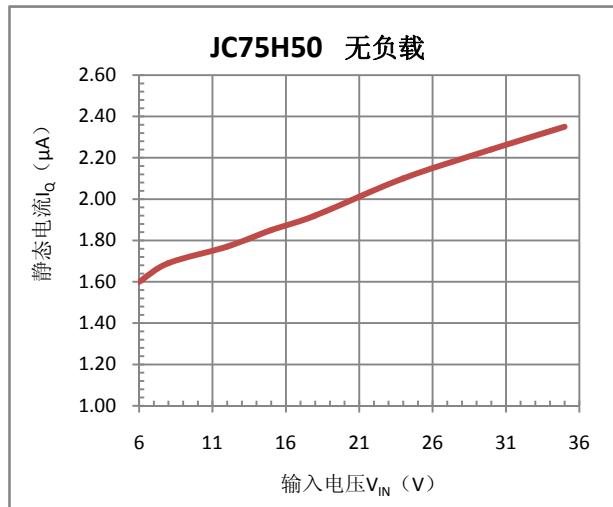
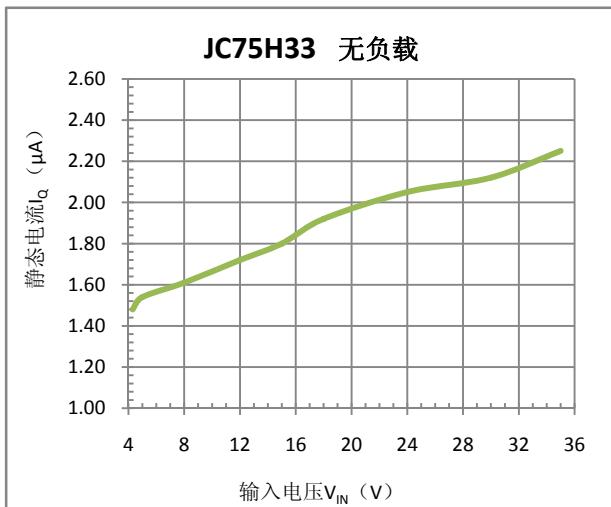
输出电压随输出电流的变化



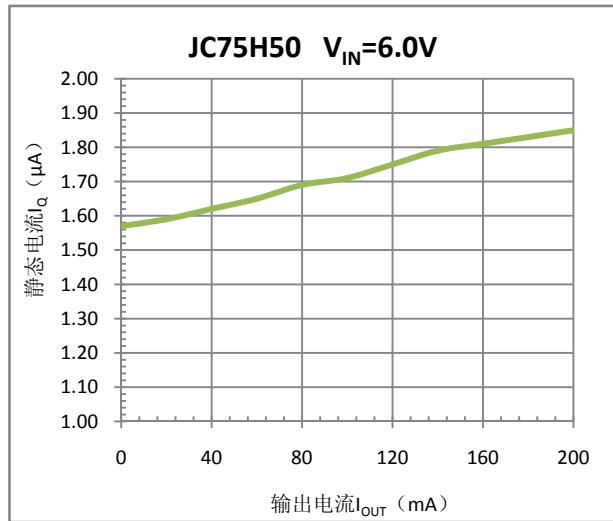
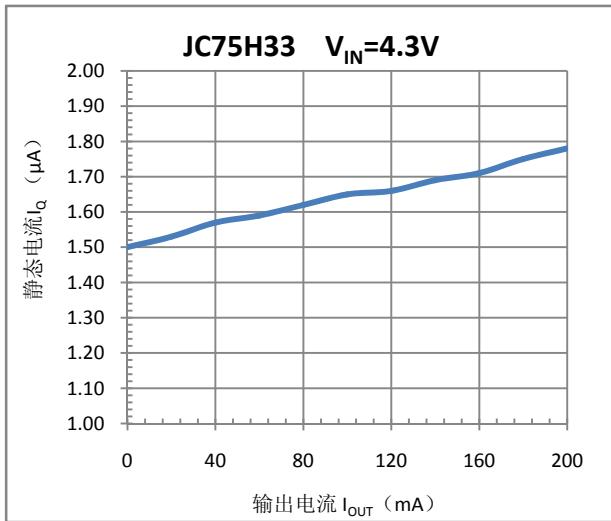
输出电压随温度的变化



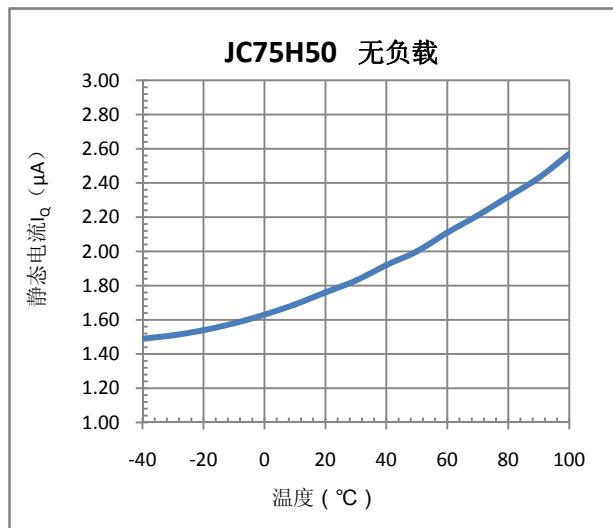
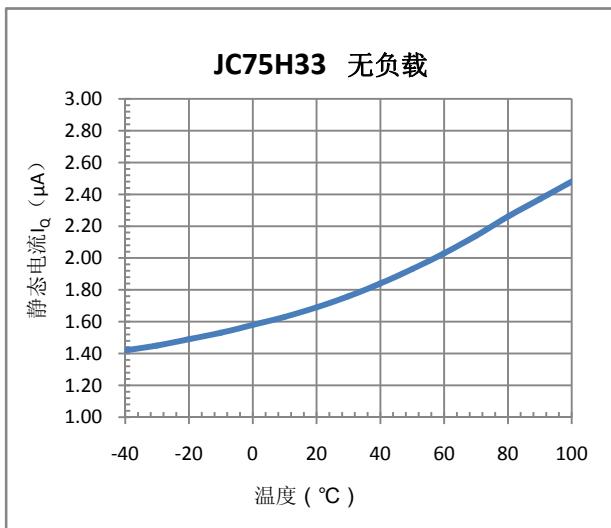
静态电流随输入电压的变化



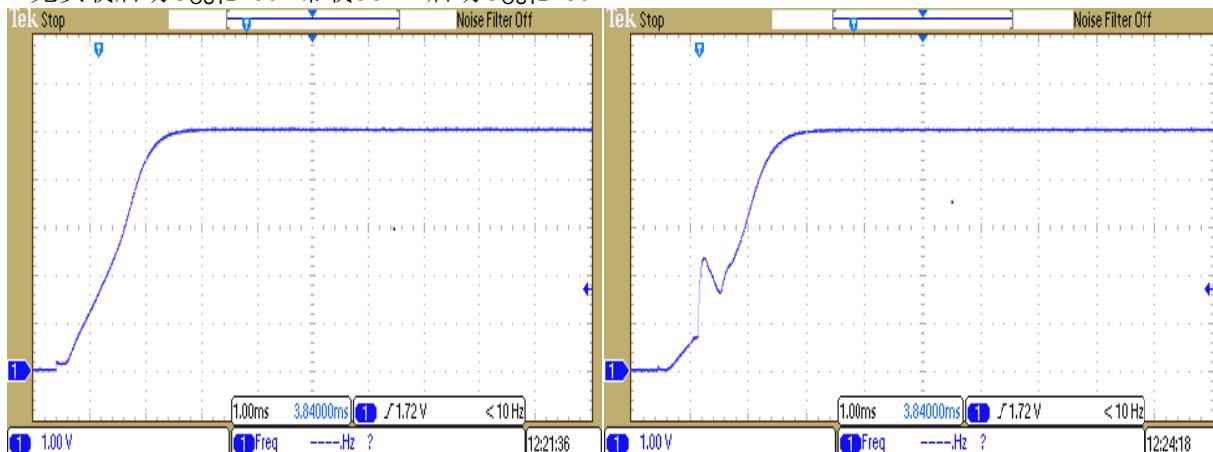
静态电流随输出电流的变化



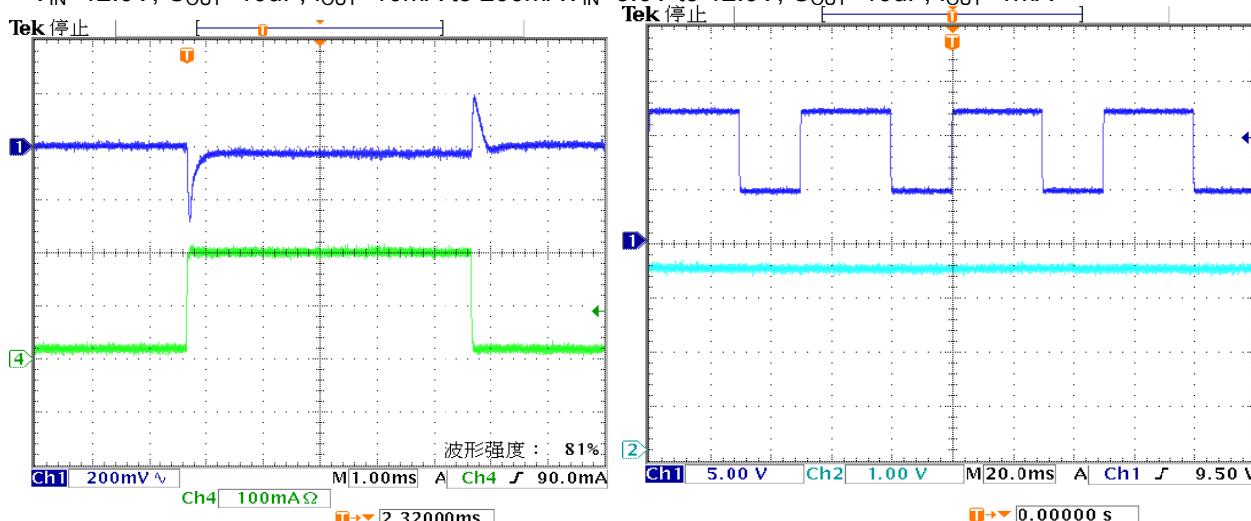
静态电流对温度的变化



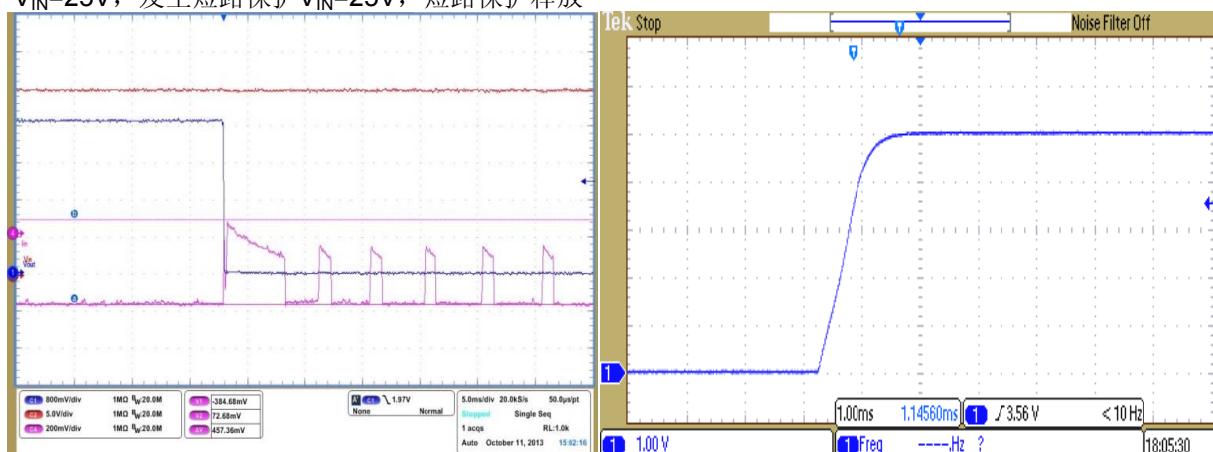
系统空载和带载启动

无负载启动 $C_{OUT}=10\mu F$ 带载30mA启动 $C_{OUT}=10\mu F$ 

负载跳变的瞬态响应电源跳变的瞬态响应

 $V_{IN}=12.0V$, $C_{OUT}=10\mu F$, $I_{OUT}=10mA$ to $200mA$ $V_{IN}=5.0V$ to $12.0V$, $C_{OUT}=10\mu F$, $I_{OUT}=1mA$ 

短路保护与释放

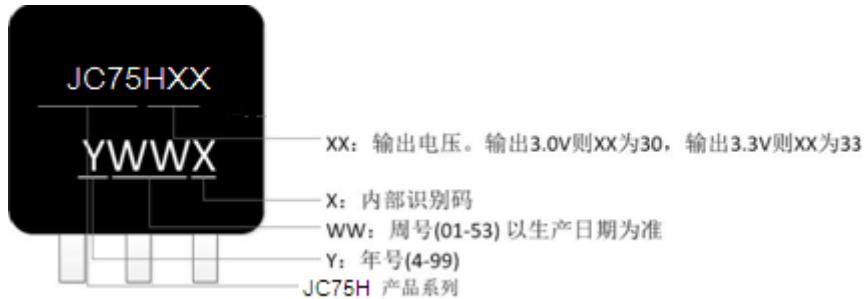
 $V_{IN}=25V$, 发生短路保护 $V_{IN}=25V$, 短路保护释放

■ 产品选型

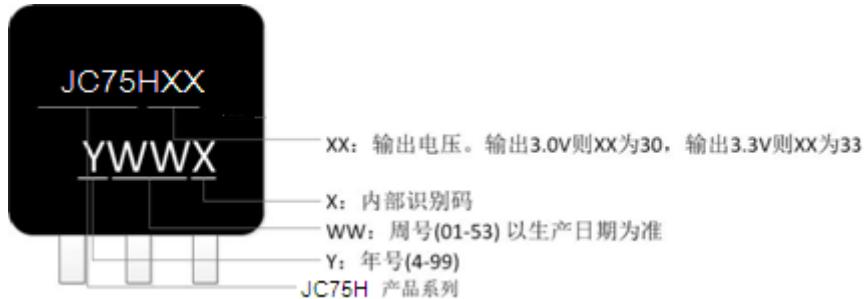
产品型号 (XX: 封装形式代码)	最高输入电压(V)	输出电压 (V)	精度	包装方式及最小订货数量			
				SOT23 代码:SC	SOT23-5 代码:TG	SOT89 代码:TS	TO92 代码:TY
JC75H18AXX	35V	1.8	1%				
JC75H18BXX	35V	1.8	2%				
JC75H25AXX	35V	2.5	1%				
JC75H25BXX	35V	2.5	2%				
JC75H30AXX	35V	3.0	1%				
JC75H30BXX	35V	3.0	2%				
JC75H33AXX	35V	3.3	1%				
JC75H33BXX	35V	3.3	2%				
JC75H36AXX	35V	3.6	1%				
JC75H36BXX	35V	3.6	2%				
JC75H40AXX	35V	4.0	1%				
JC75H40BXX	35V	4.0	2%				
JC75H42AXX	35V	4.2	1%				
JC75H42BXX	35V	4.2	2%				
JC75H50AXX	35V	5.0	1%				
JC75H50BXX	35V	5.0	2%				

■ 打标信息

SOT89-3/TO92 打标

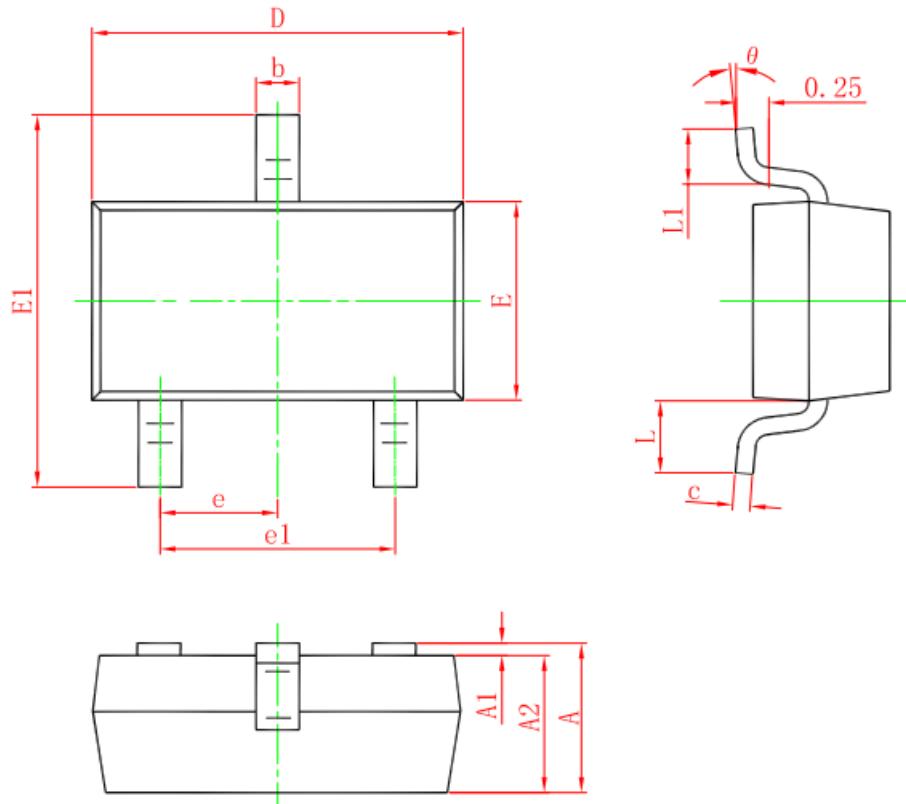


SOT23/SOT23-5 打标



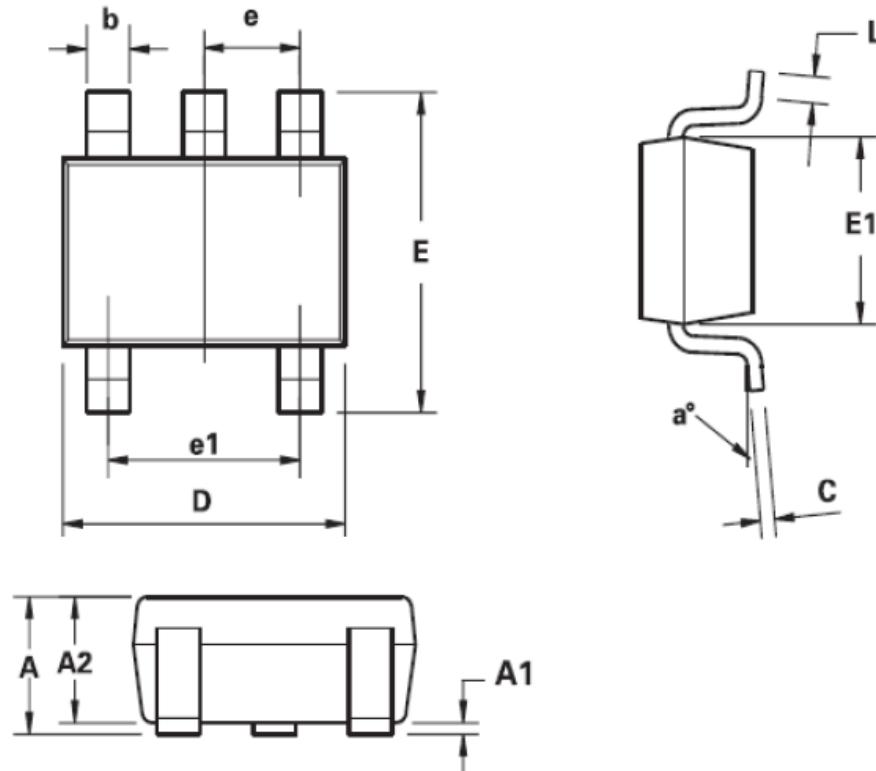
■ 封装信息

3-Pin SOT23 Package



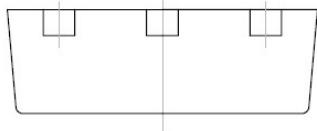
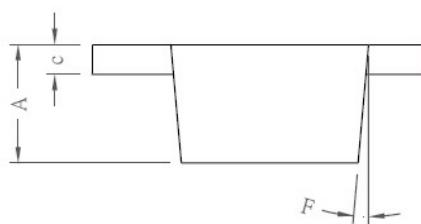
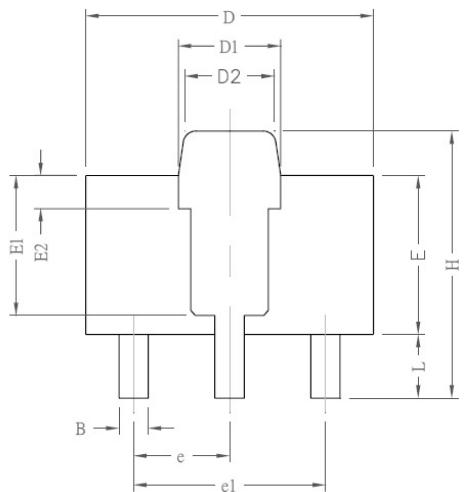
Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP.		0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022 REF.	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°

5-Pin SOT23-5



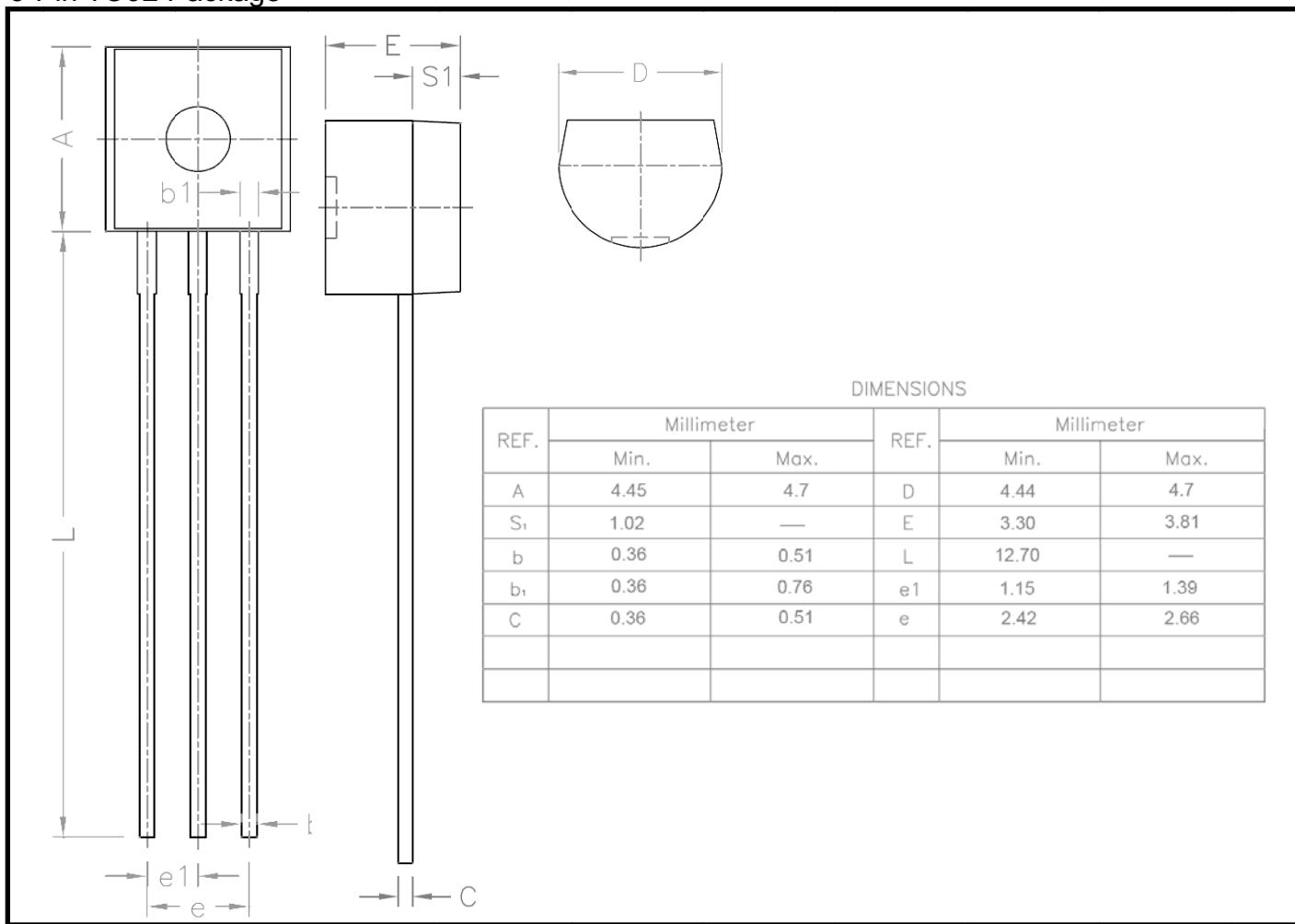
DIM	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.90	1.45	0.0354	0.0570
A1	0.00	0.15	0.00	0.0059
A2	0.90	1.30	0.0354	0.0511
b	0.20	0.50	0.0078	0.0196
C	0.09	0.26	0.0035	0.0102
D	2.70	3.10	0.1062	0.1220
E	2.20	3.20	0.0866	0.1181
E1	1.30	1.80	0.0511	0.0708
e	0.95 REF		0.0374 REF	
e1	1.90 REF		0.0748 REF	
L	0.10	0.60	0.0039	0.0236
a°	0°	30°	0°	30°

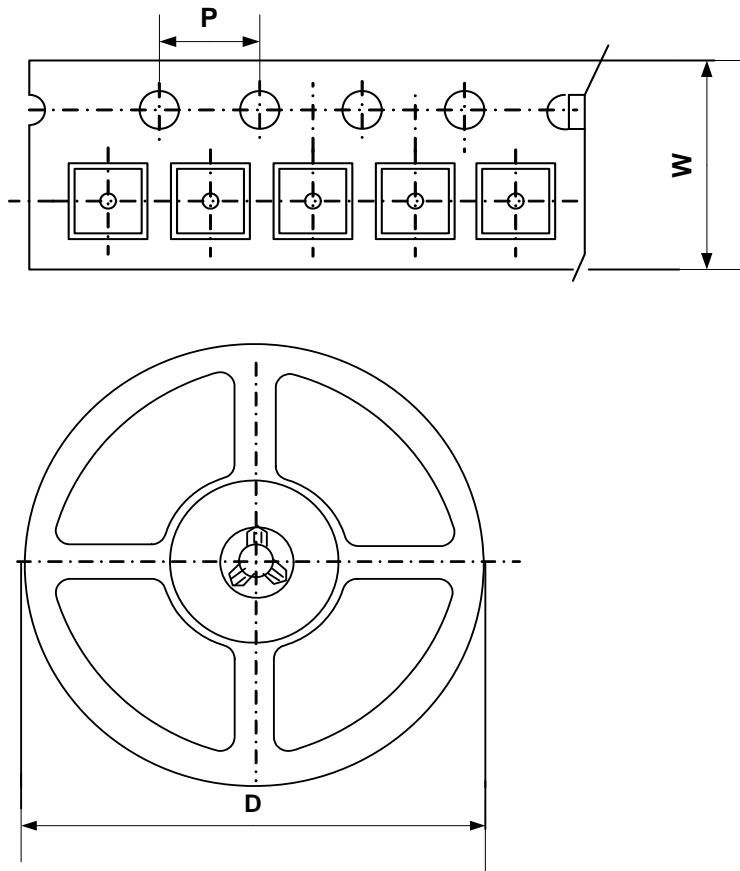
3-Pin SOT89-3 Package



REF.	DIMENSIONS	
	Millimeters	
	Min.	Max.
A	1.40	1.60
B	0.40	0.52
c	0.35	0.41
D	4.40	4.60
D1	1.50	1.70
D2	1.30	1.50
E	2.40	2.60
E1	2.20 REF.	
E2	0.52 REF.	
e	1.50 REF.	
e1	3.00 REF.	
F	5° TYP.	
H	4.05	4.25
L	0.89	1.20

3-Pin TO92 Package



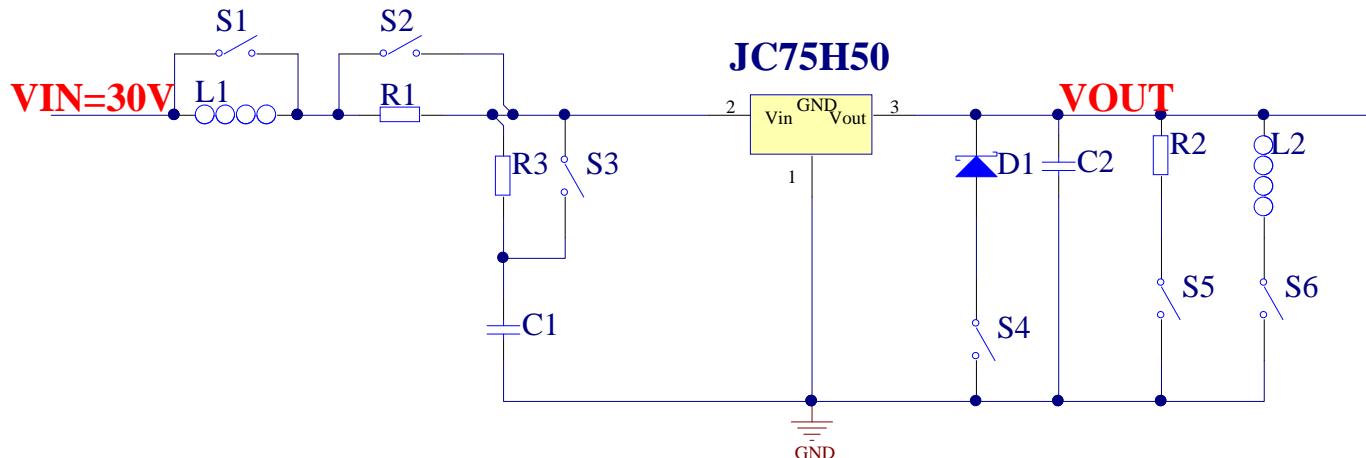
■ 卷盘编带规格

封装形式	载带宽度 W(mm)	间距 P(mm)	卷盘直径 D(mm)	最小包装数(pcs)
SOT23 SOT23-5	8.0±0.1 mm	4.0±0.1 mm	180±1 mm	3000pcs
SOT89-3	12.0±0.1 mm	4.0±0.1 mm	180±1 mm	1000pcs
TO92-3	/	/	/	1,000pcs/袋 10,000pcs/盒

应用指南:

1、 输出输入电容选取及输入电路设计

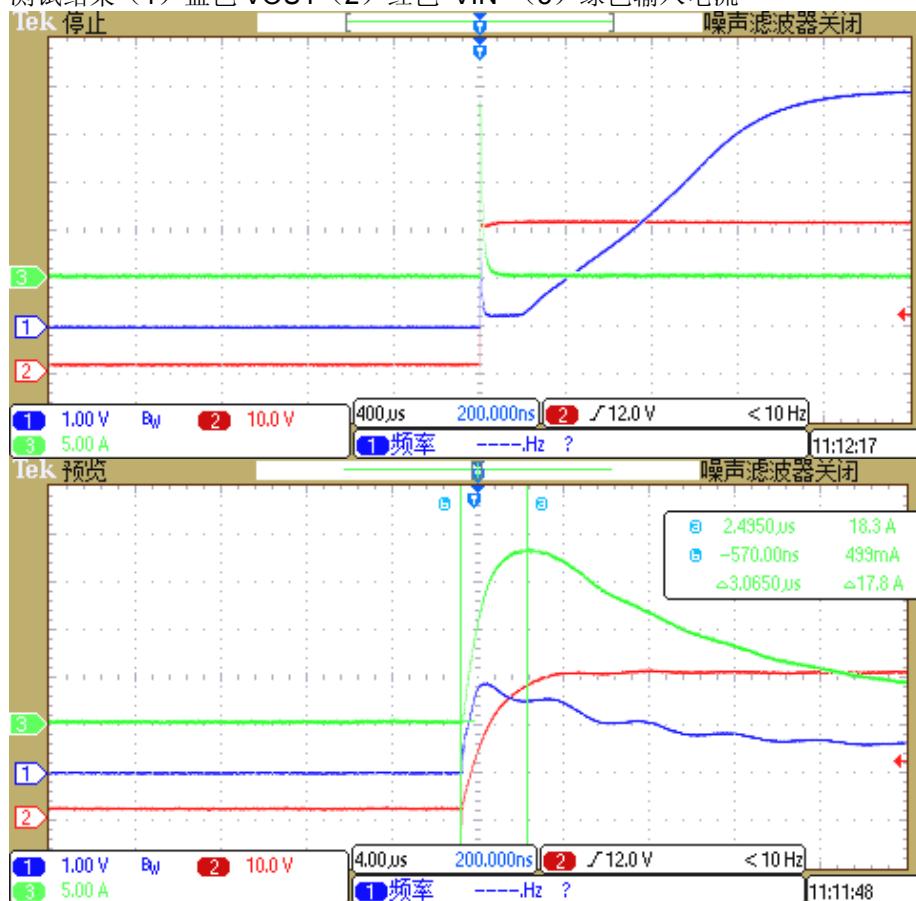
a、测试电路



b、测试条件及测试结果

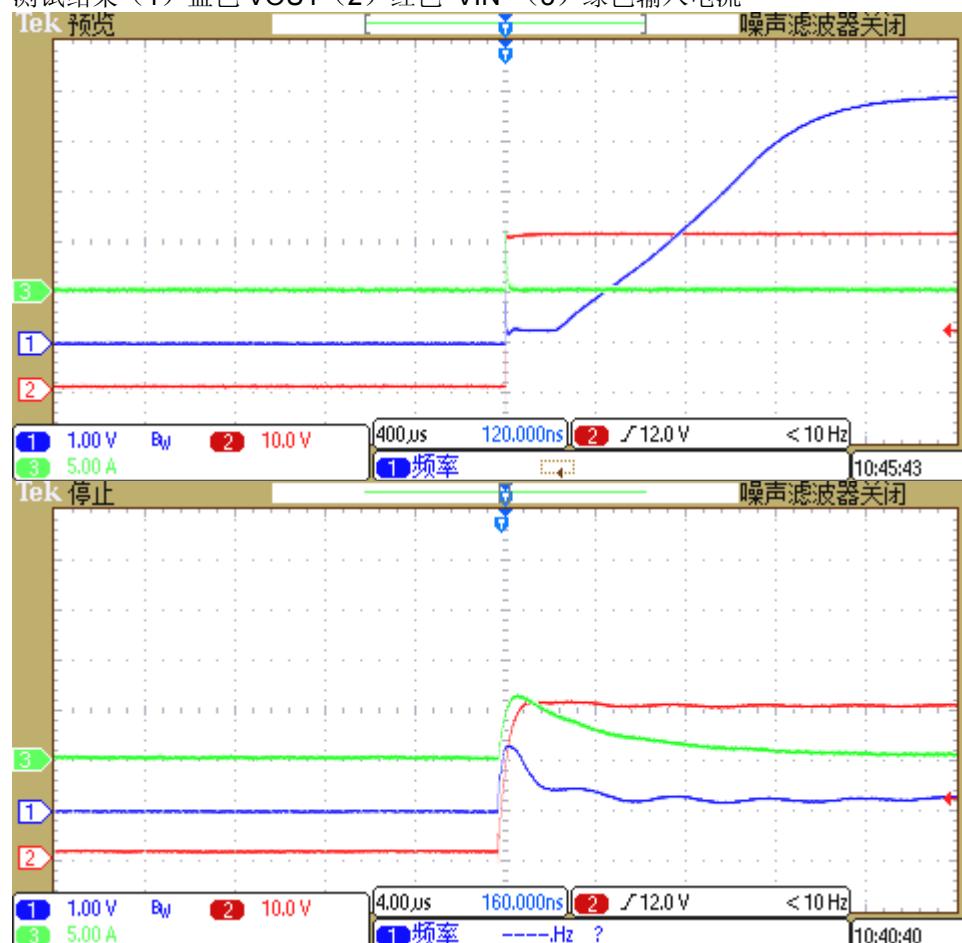
S1,S2,S3 闭合
 $C_1=10\mu F 50V$ (电解电容),
 $C_2=10\mu F 10V$ (电解电容)
S4 开路
S5 闭合, $R_2=510\Omega$
S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 V_{OUT} (2) 红色 V_{IN} (3) 绿色输入电流



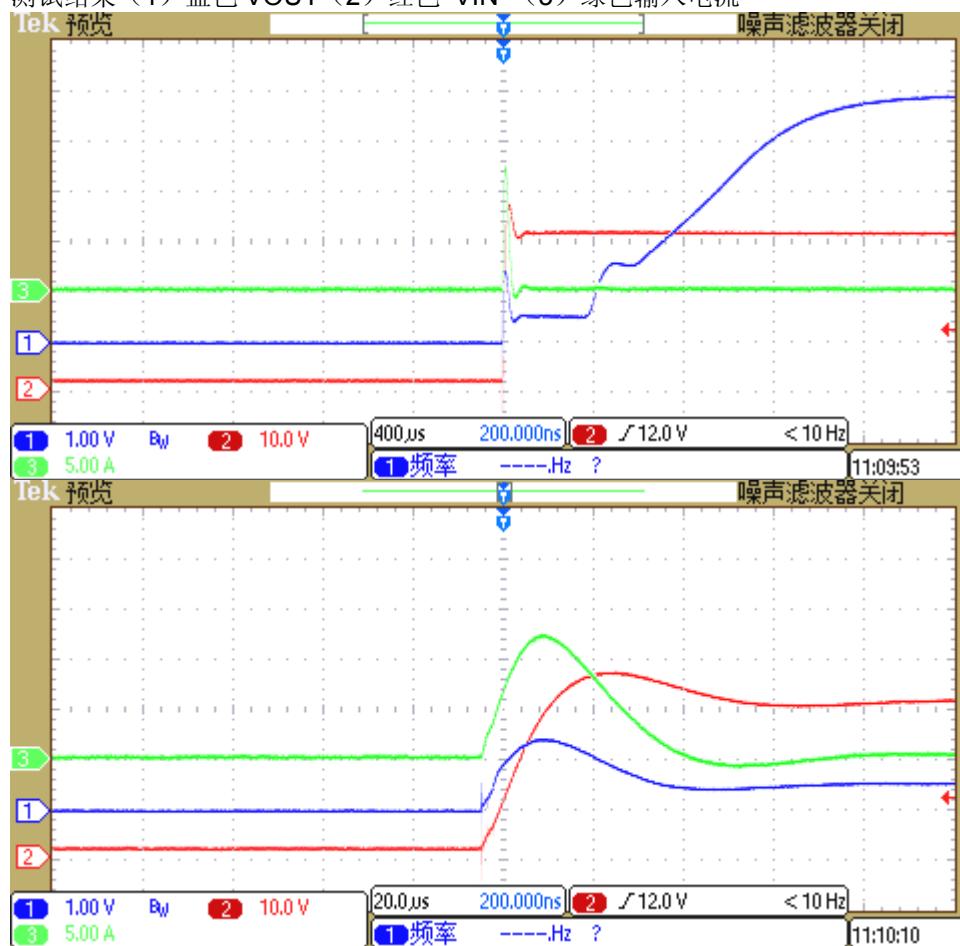
S1,S2,S3 闭合
 C1=1uF50V(电解电容)
 C2=10uF10V(电解电容)
 S4 开路
 S5 闭合, R2=510Ω
 S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流



S1 开路, L1=5uH
 S2,S3 闭合
 C1=10uF50V(电解电容)
 C2=10uF10V(电解电容)
 S4 开路
 S5 闭合, R2=510Ω
 S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流



S1 开路, L1=5uH

S2,S3 闭合

C1=1uF50V(电解电容)

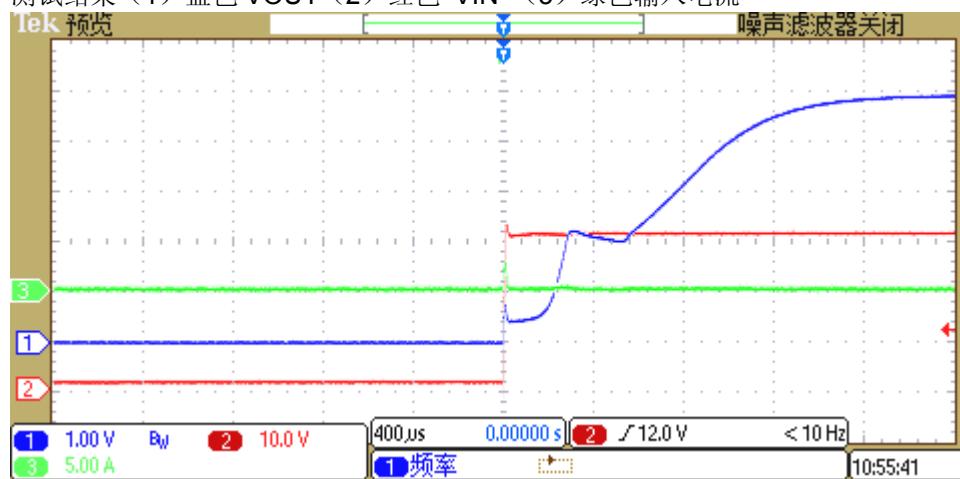
C2=10uF10V(电解电容)

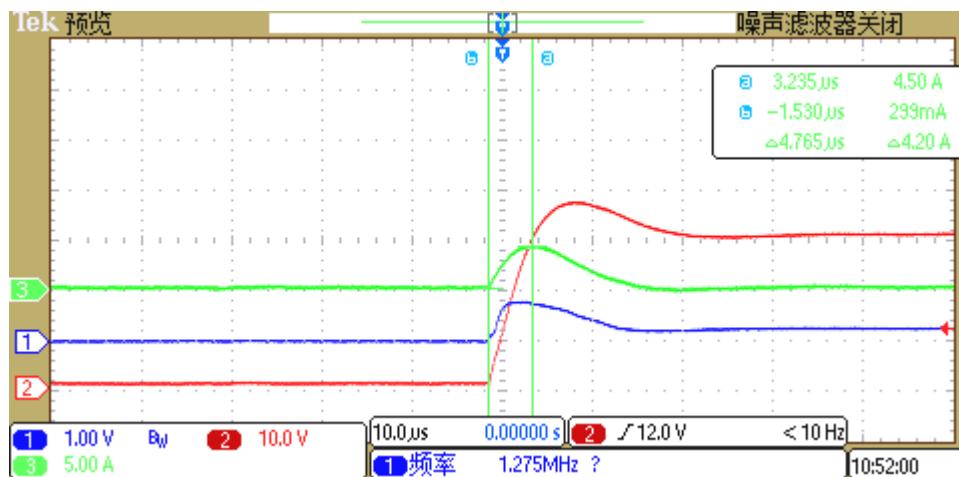
S4 开路

S5 闭合, R2=510Ω

S6 开路

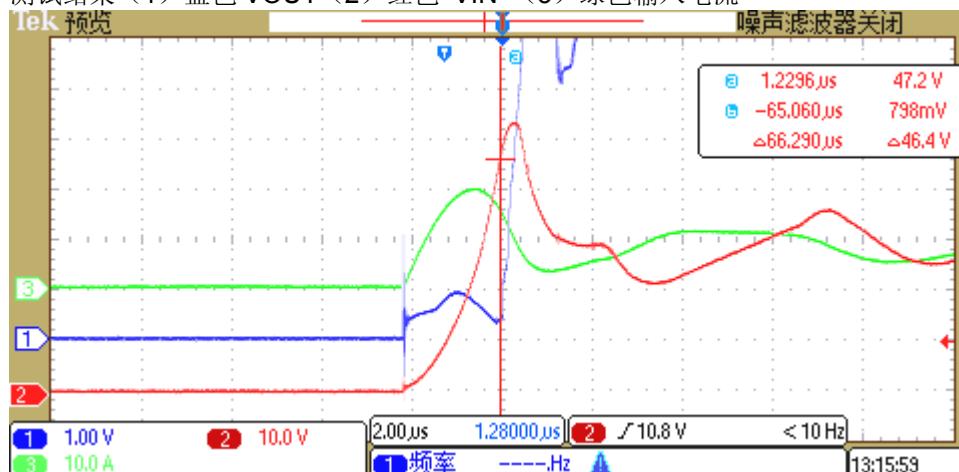
测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流





S1,S2,S3 闭合
C1=1uF50V(贴片瓷片电容)
C2=10uF10V(电解电容)
S4 开路
S5 闭合, R2=510 Ω
S6 开路

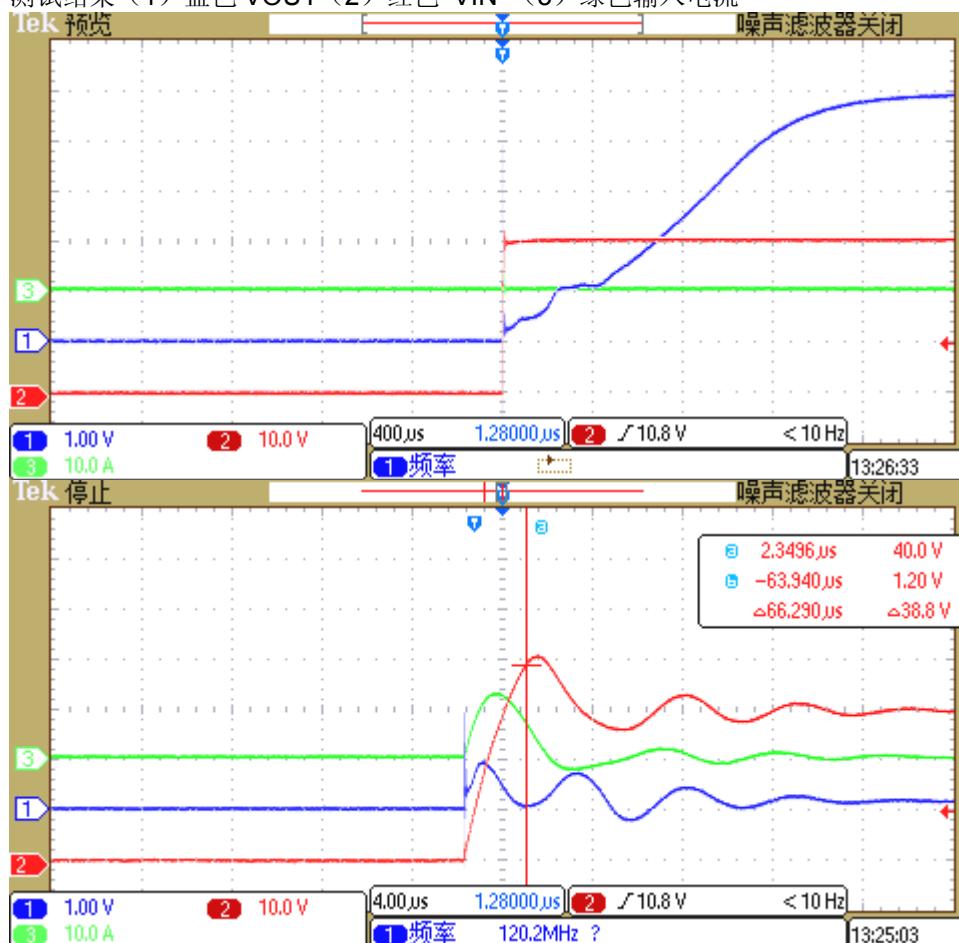
测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流



输入端电压过冲，峰值电压达 54V 左右，IC 过压击穿

S1,S2 闭合
S3 开路 R3=1 Ω
C1=1uF50V(贴片瓷片电容)
C2=10uF10V(电解电容)
S4 开路
S5 闭合, R2=510 Ω
S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流



S1,S2 闭合

S3 开路 R3=10 Ω

C1=1uF50V(贴片瓷片电容)

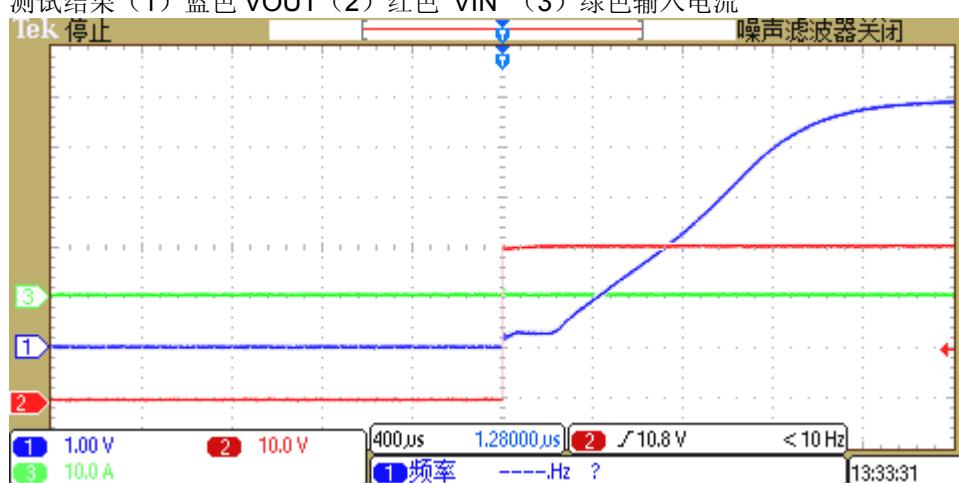
C2=10uF10V(电解电容)

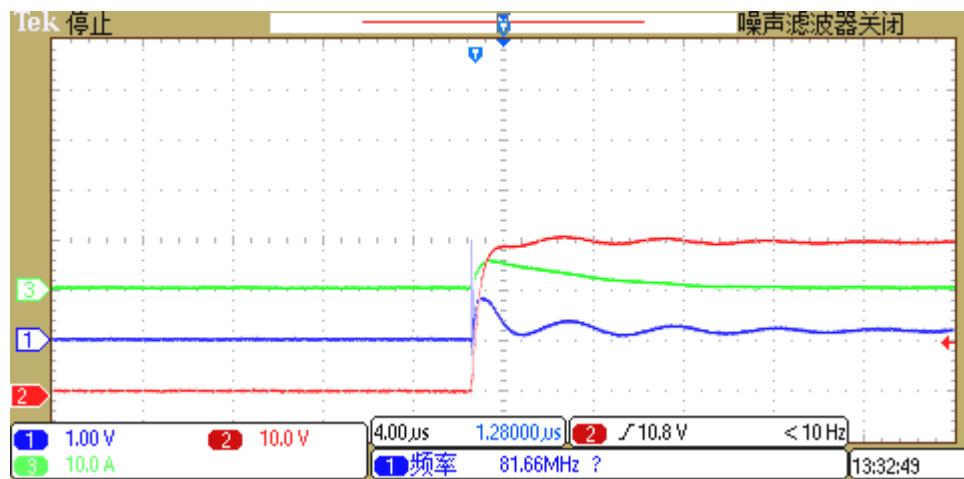
S4 开路

S5 闭合, R2=510 Ω

S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流





S1,S2,S3 闭合

C1=10uF50V(贴片瓷片电容)

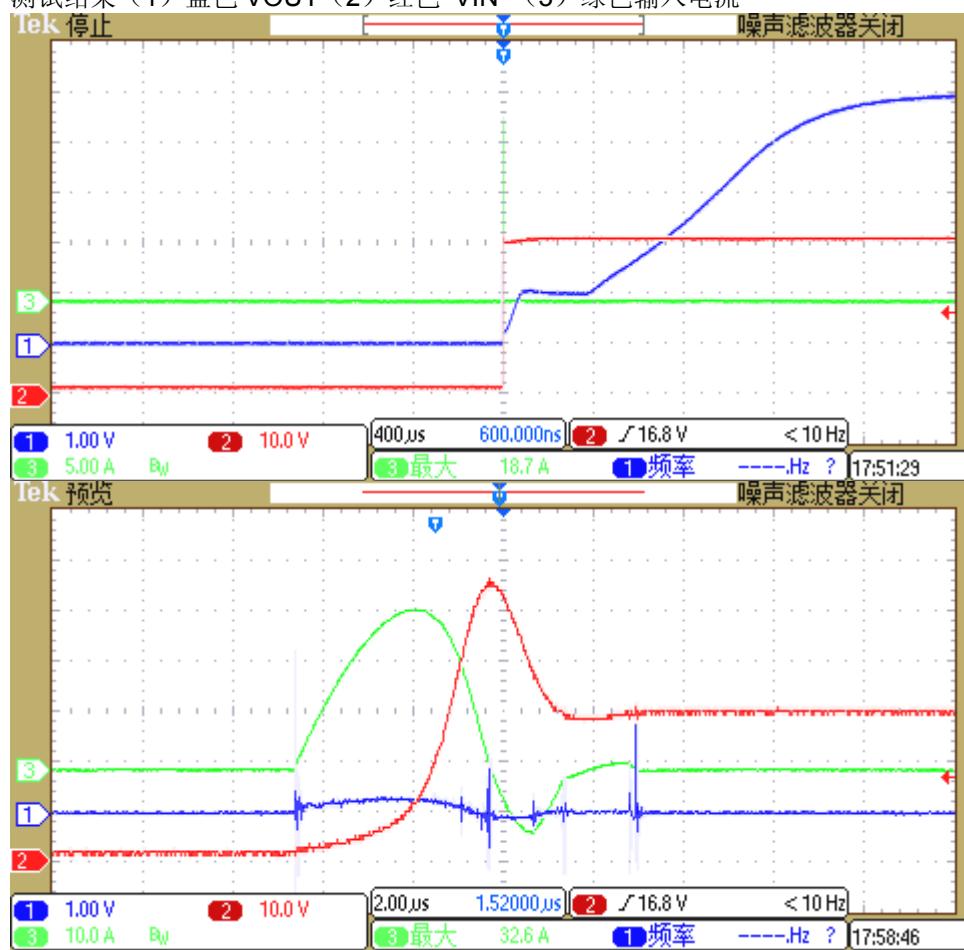
C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合, R2=510 Ω

S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流



S1,S2 闭合

S3 开路 R3=1Ω

C1=10uF50V(贴片瓷片电容)

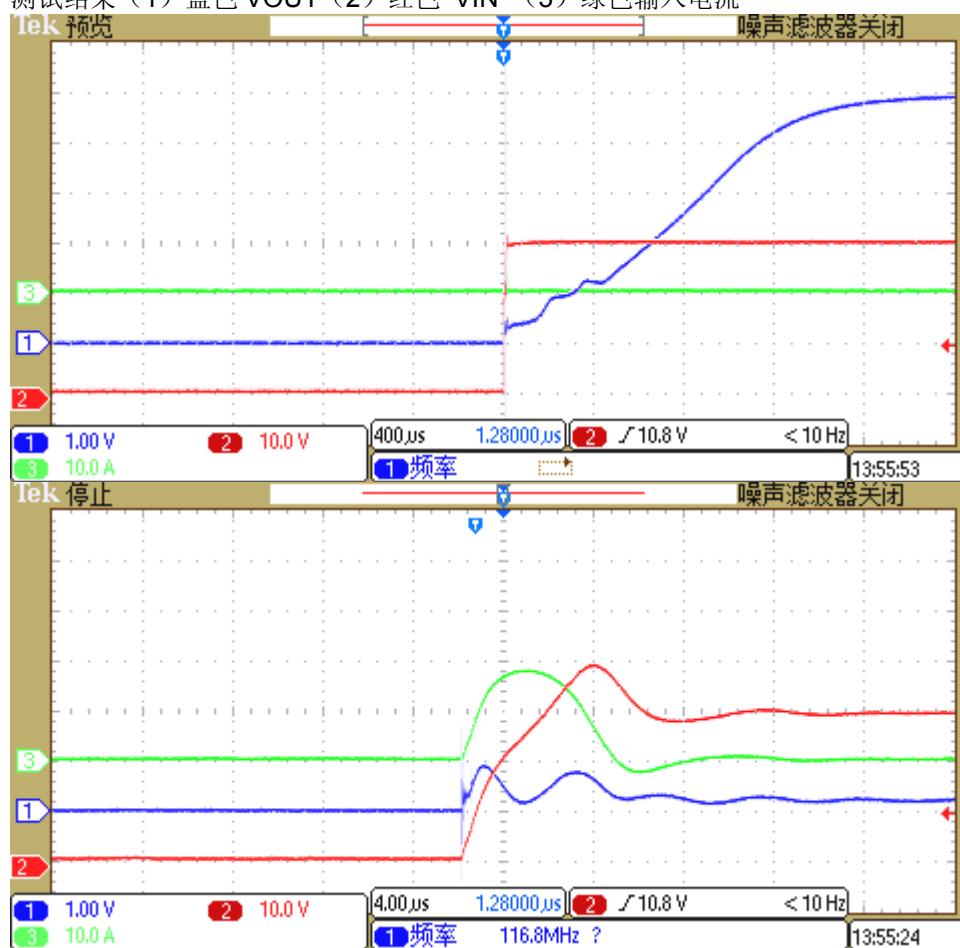
C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合, R2=510Ω

S6 开路

测试结果 (1) 蓝色 VOUT (2) 红色 VIN (3) 绿色输入电流



S1,S2 闭合

S3 开路 R3=10Ω

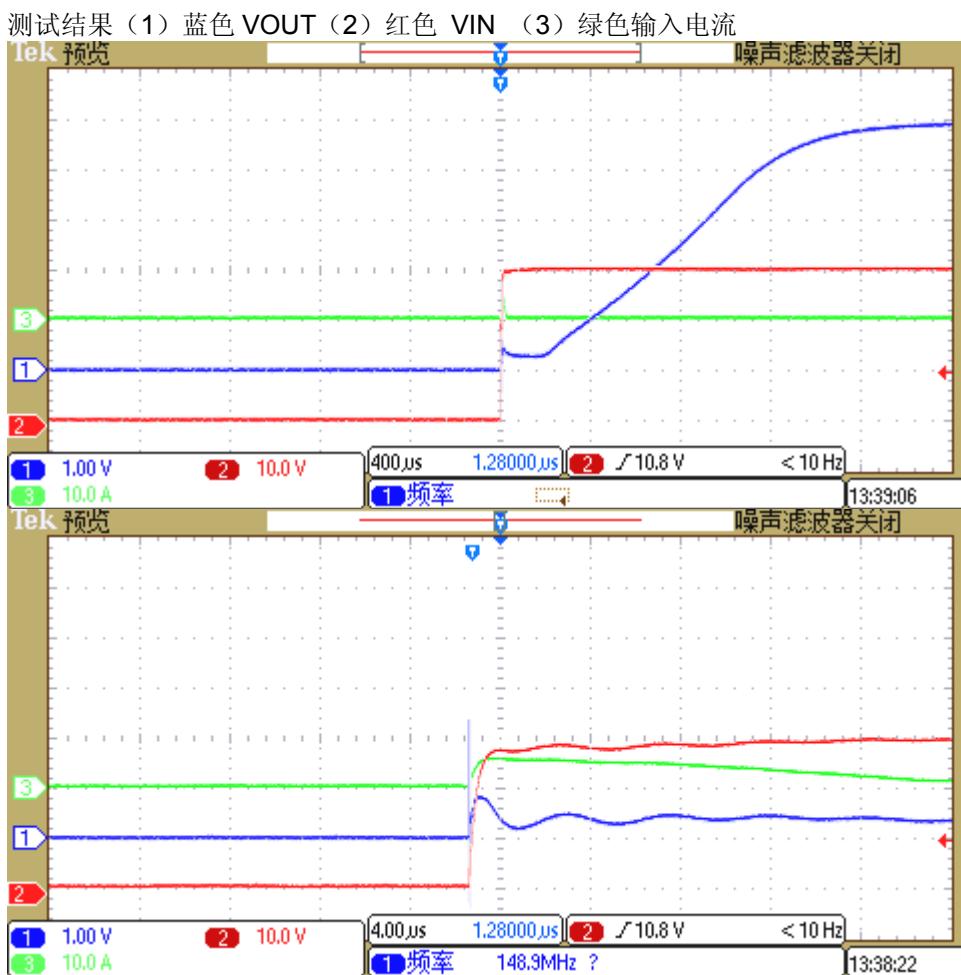
C1=10uF50V(贴片瓷片电容)

C2=10uF10V(电解电容)

S4 开路

S5 闭合, R2=510Ω

S6 开路



实验结论：

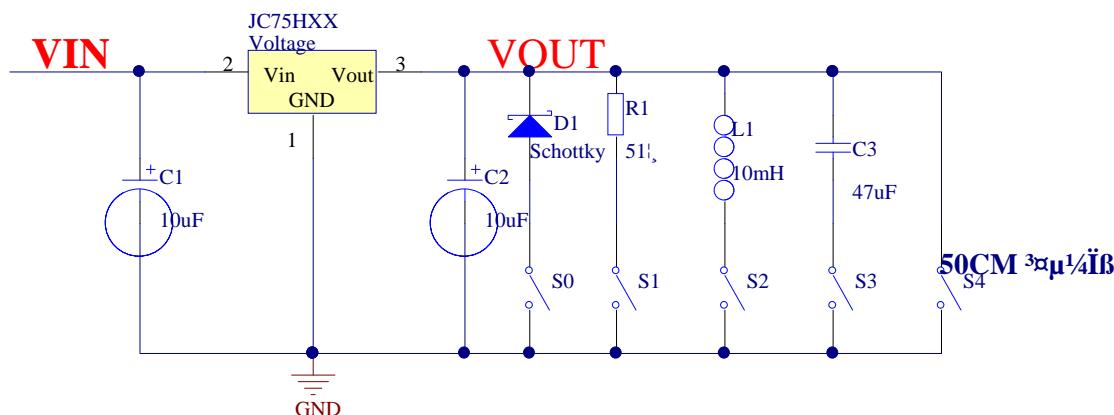
在输入电压上升较快的系统中，由于线路中寄生电感的原因，导致上电过程产生 **LC** 谐振，导致输入电压过冲，峰值最大可导致**2**倍输入电压，容易造成 **LDO** 过压击穿。

在实验过程做可以看出，选择 **ESR** 较大的电容（如电解电容），或串入一个 **1-10Ω** 的电阻以降低风险（但需要注意电阻抗电流冲击能力选择），实验中可以看出，上电瞬间，不同容值电容充电电流可以达到几安至几十安。根据不同容值的电容，应该选择相应的阻值及电阻功率。

另外，寄生电感对电路可靠性产生极大影响，在 **PCB** 布线及外接电源时，需尽量减小线路长度及考虑适当的走线方式，以减小寄生电感的电感量。

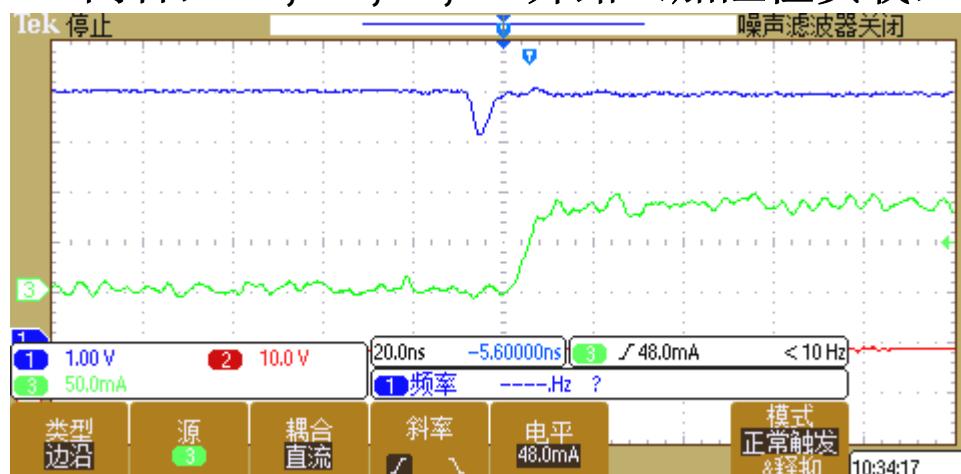
2、输出短路或过载

a、测试电路

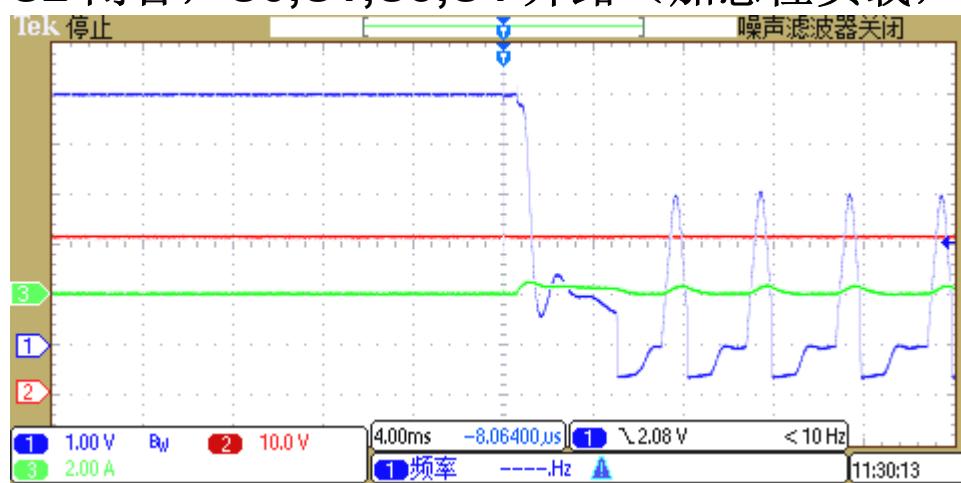


b、测试条件及测试数据

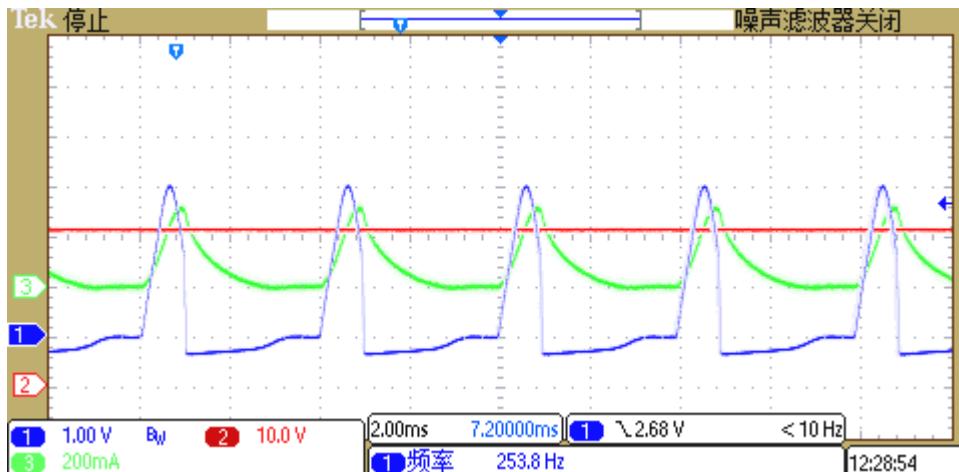
S1 闭合, **S0, S2, S3, S4** 开路 (加阻性负载)



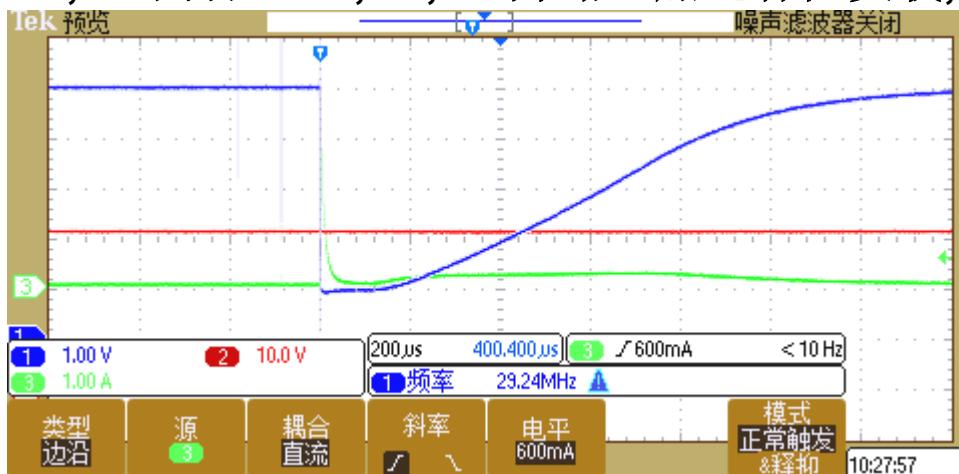
S2 闭合, **S0, S1, S3, S4** 开路 (加感性负载, 过载情况下)



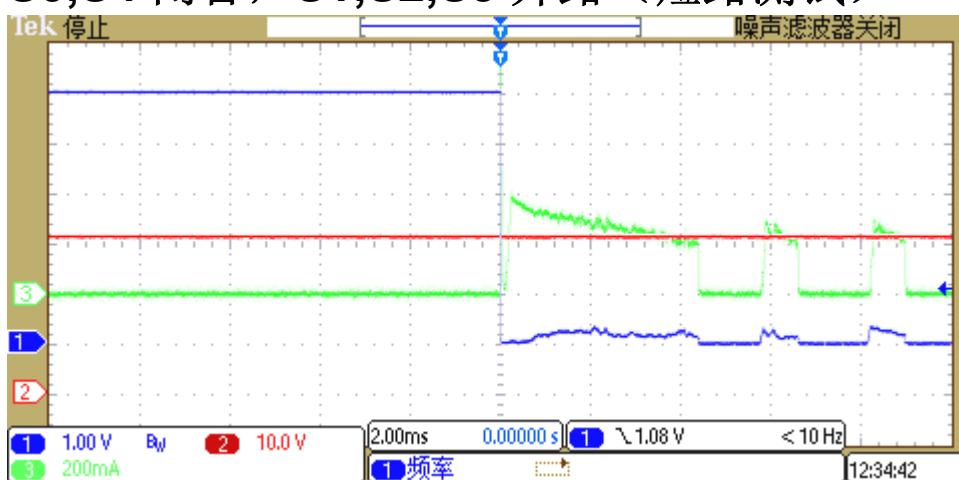
S0,S2 闭合, S1,S3,S4 开路 (加感性负载, 过载情况下, 加肖特基管保护)



S0,S3 闭合, S1,S2,S4 开路 (加纯容性负载,过载情况)



S0,S4 闭合, S1,S2,S3 开路 (短路测试)

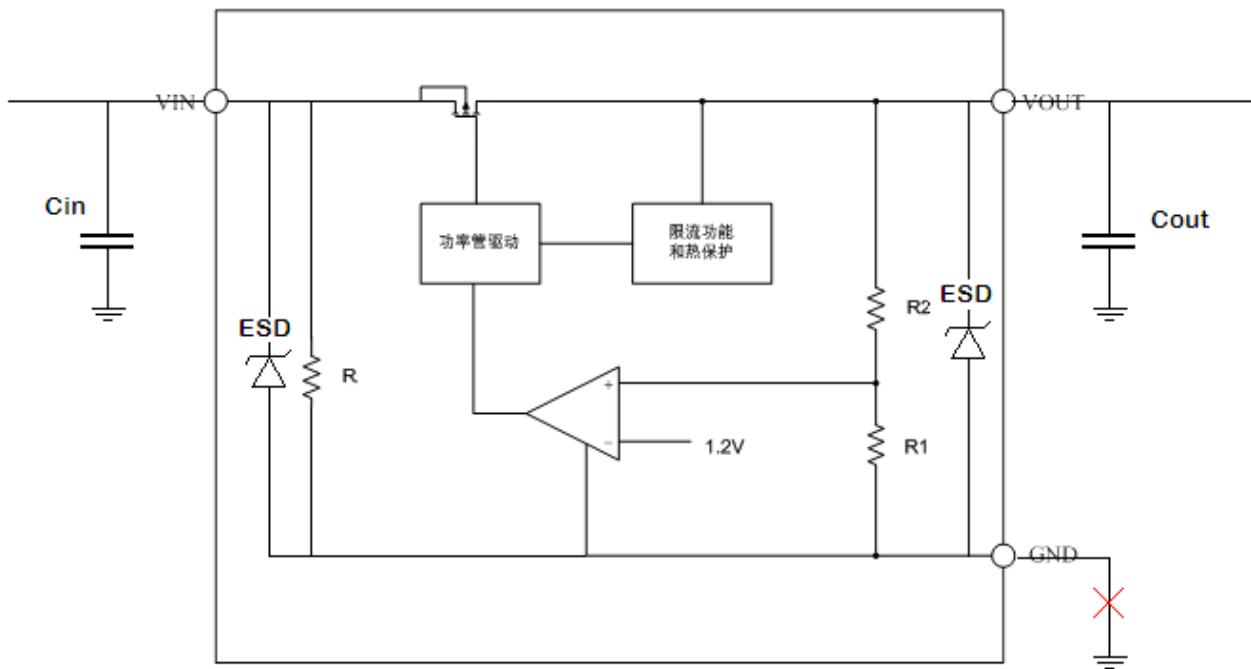


测试结论：

在应用过程中，使用感性负载（如直流电机，继电器，喇叭等）时，应该尽量避免过载。因为如果发生过载，**LDO**会进入过载保护，但是由于电感上电流不能突变，导致通过**LDO**输出端**ESD**器件续流，输出端产生负压，容易造成**ESD**器件损伤。在这种应用中，尽量增加肖特基二极管以保护**LDO**的**ESD**器件。在短路测试时，需要考虑使用短路导线的长度，尽量减少寄生电感。以免造成**ESD**器件损伤。如果经过短路测试后，发现输出电压升高，则**ESD**器件已经受损。

在应用过程中，大的容性负载，在接通负载瞬间会导致输出电压被瞬间拉低，可能会导致应用电路不稳定。

3、生产过程控制



LDO内部示意框图及基本外部电路

从内部框图及应用电路可以看出，如果 LDO 的 GND 脚与线路板的地线虚焊，在外部无负载时，会导致 VIN 电压通过 R,R1, R2 给 Cout 充电，使 $V_{cout}=Vin$ 。此时如果没有给 Cout 放电，直接补焊 GND pin, 由于输出端 ESD 为 6.5V 保护器件，Cout 会通过 ESD 器件瞬间放电，导致 ESD 器件受损。所以，在生产过程中应该避免这种情况发生。